

엠케이전자(주)

Semiconductor Materials

Global No.1



**CONNECTING
TO A BETTER WORLD**

Disclaimer

Important Notice Regarding This Document



본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 엠케이전자(주)(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며, 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재 배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)
본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약, 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융위원회에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

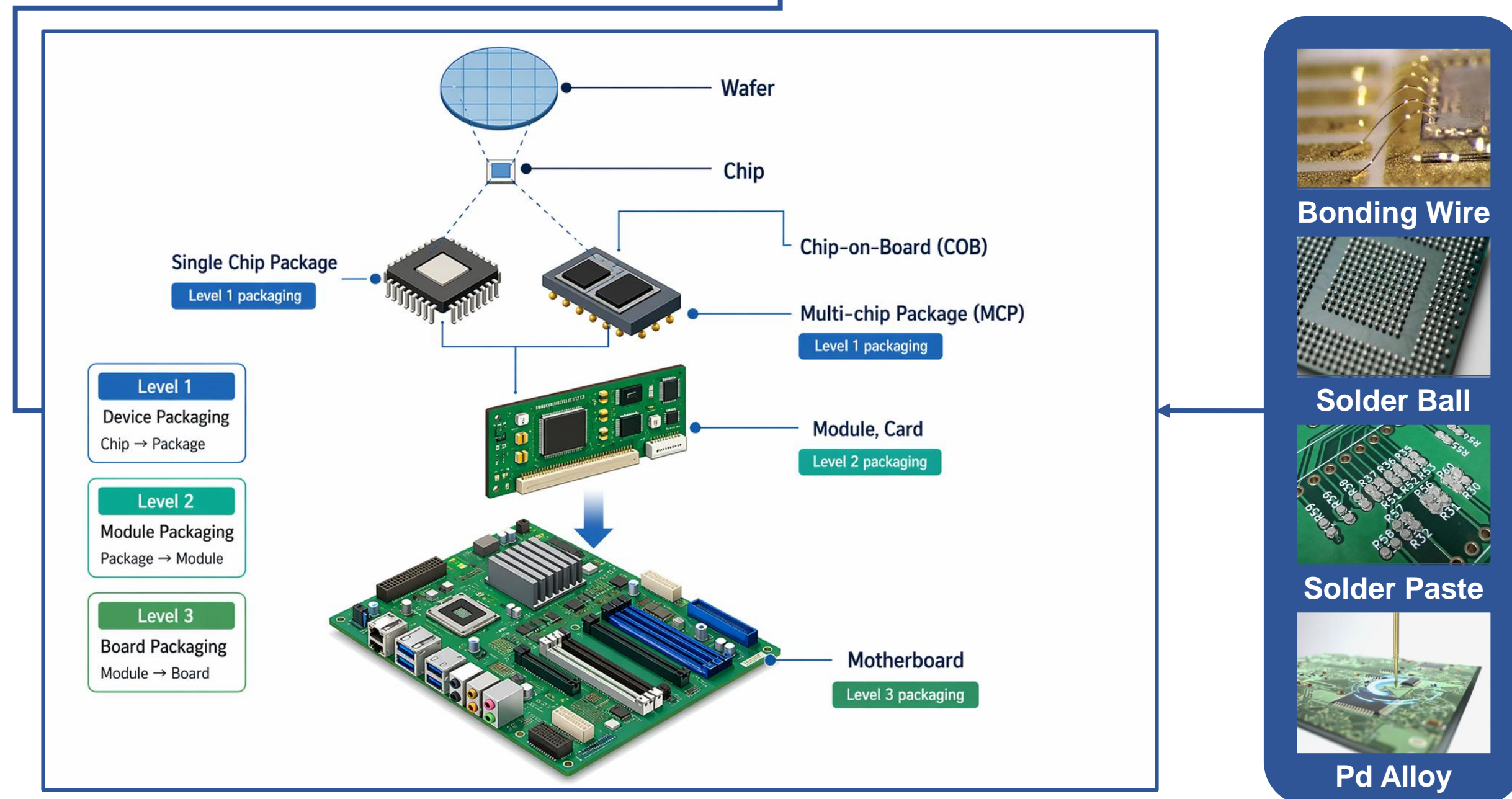
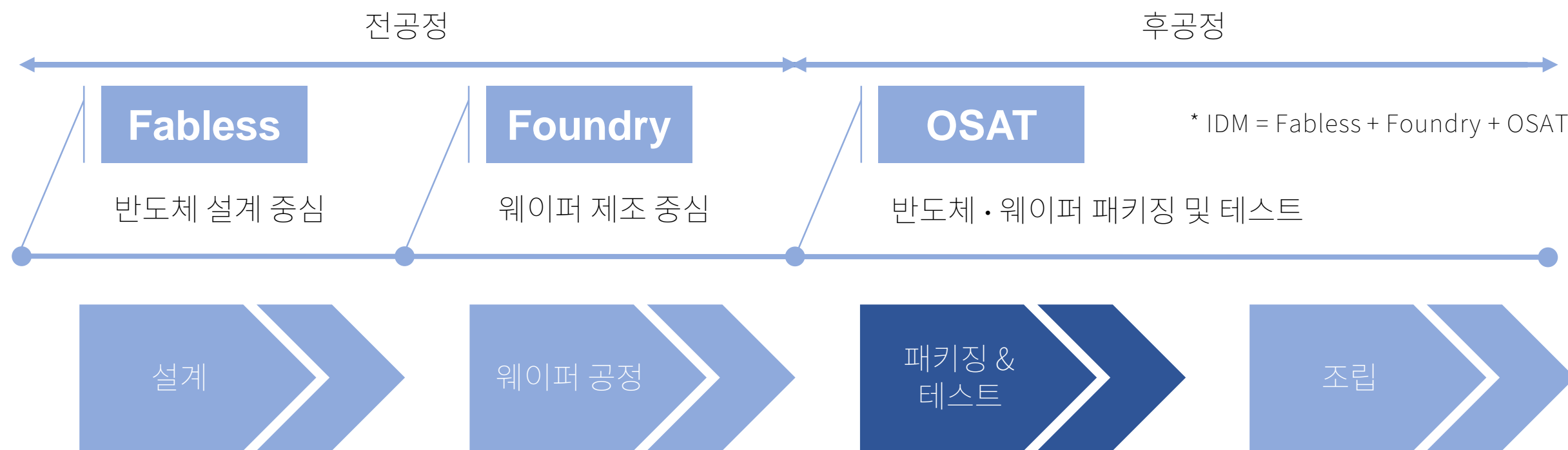


Executive Summary

Investment Highlights



반도체 공정은 '패키징 & 테스트'에서 완성



반도체 패키징 공정의 모든 "연결"을 책임지는 글로벌 핵심 소재 기업, 엠케이전자

01 포트폴리오

- 패키징 공정 전반을 아우르며, 단일 제품 의존도 ↓

02 고객·공정 기반 설계 역량

- 맞춤형 소재 설계 및 장기 거래 경험 축적, 특정 고객 의존도 ↓

03 신뢰성 검증된 양산 경쟁력

- 대량 생산 환경에서 검증된 품질 및 공급 안정성

Company Overview

Global Leader in Semiconductor Materials



MK Electron



설립/상장

- 1982년 설립 (45년차)
- 1997년 코스닥 상장



기업 규모

중견기업



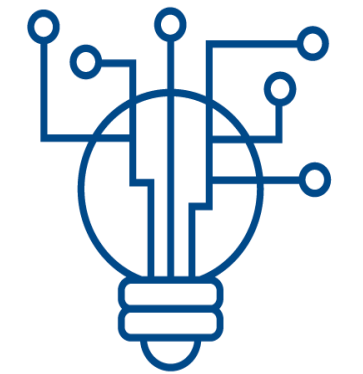
임직원

- 총 479명 ('25년 말 기준)
- 국내: 302명
- 해외: 177명



특허 현황

- 유효 특허 65건
- BW, SB, Paste, PdA



글로벌 사업장 현황

국내

Plant 1	BW, SB, PdA	용인본사
Plant 2	Paste, Recycling(후처리)	음성
Plant 3	BW(Coating)	시흥
Plant 4	Recycling(전처리)	인천
Campus	경영지원	과천

해외

MKEC	BW, SB	중국 쿤산
Taiwan Branch	Sales	대만
Vietnam Branch	Sales	베트남



투명하고 안정적인 지배구조

01

명확한 의사결정 구조

- 단일 대주주 중심의 일관성 확보

02

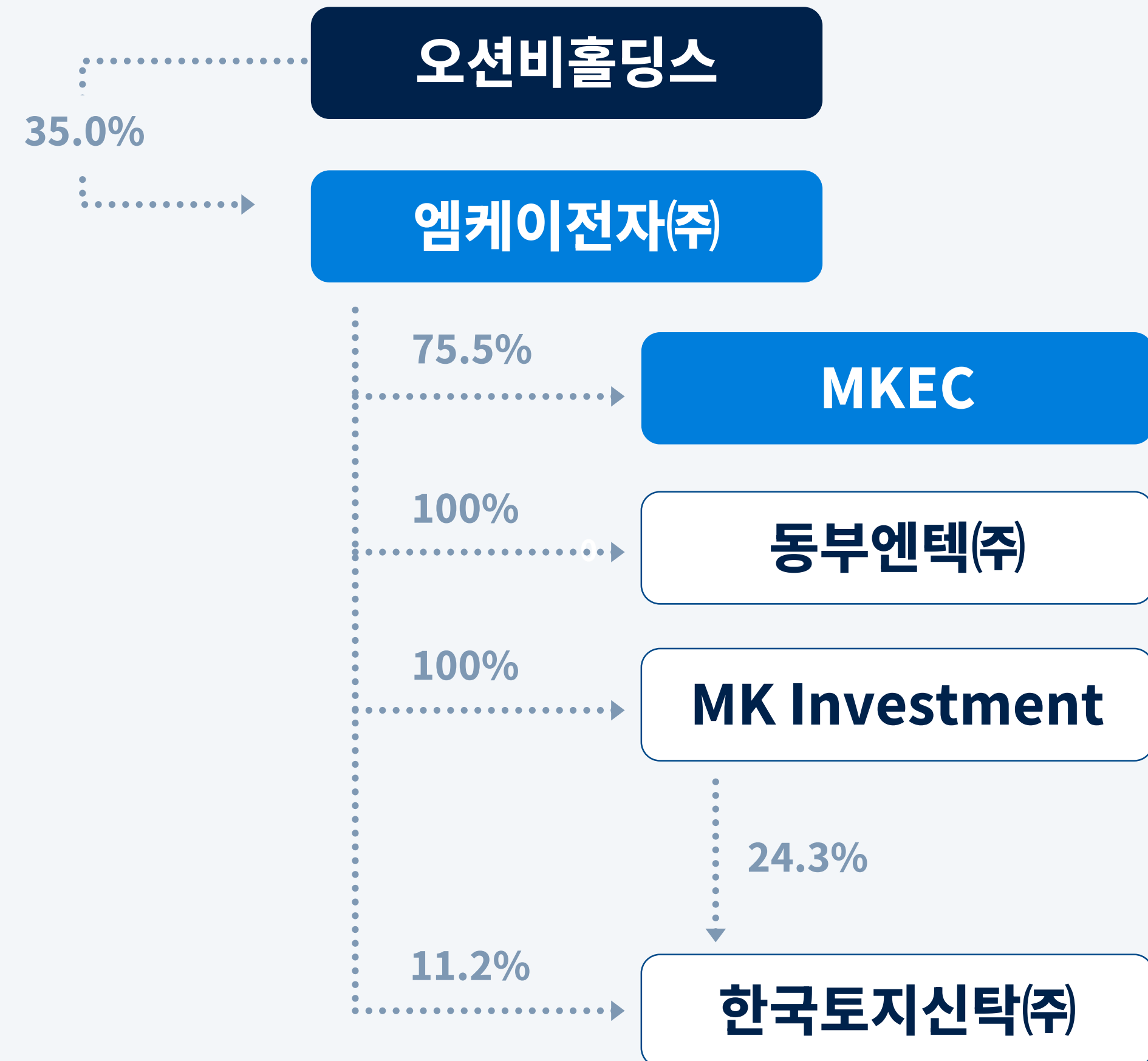
지배구조 안정성

- 주요 해외 생산 법인, 자회사에 대한 안정적 지배권 확보

03

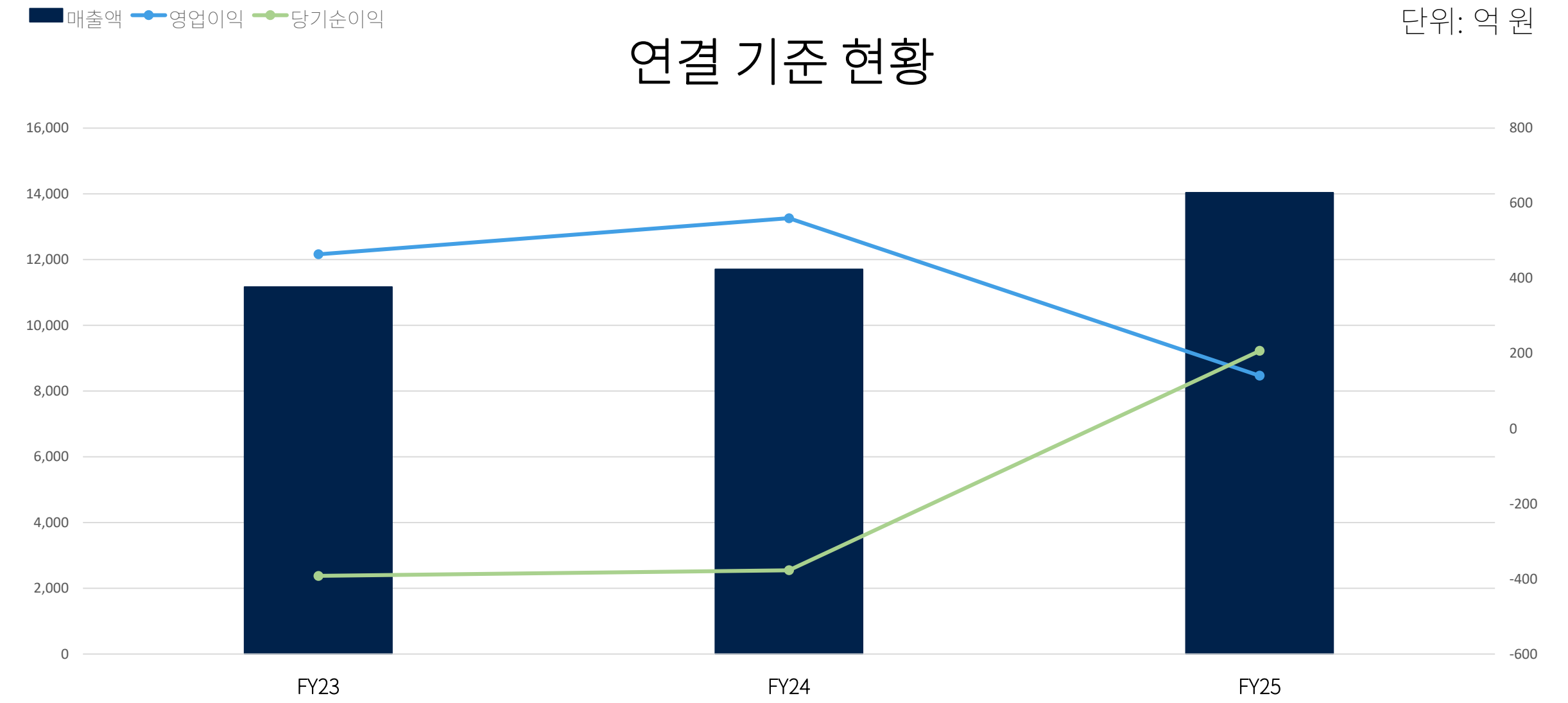
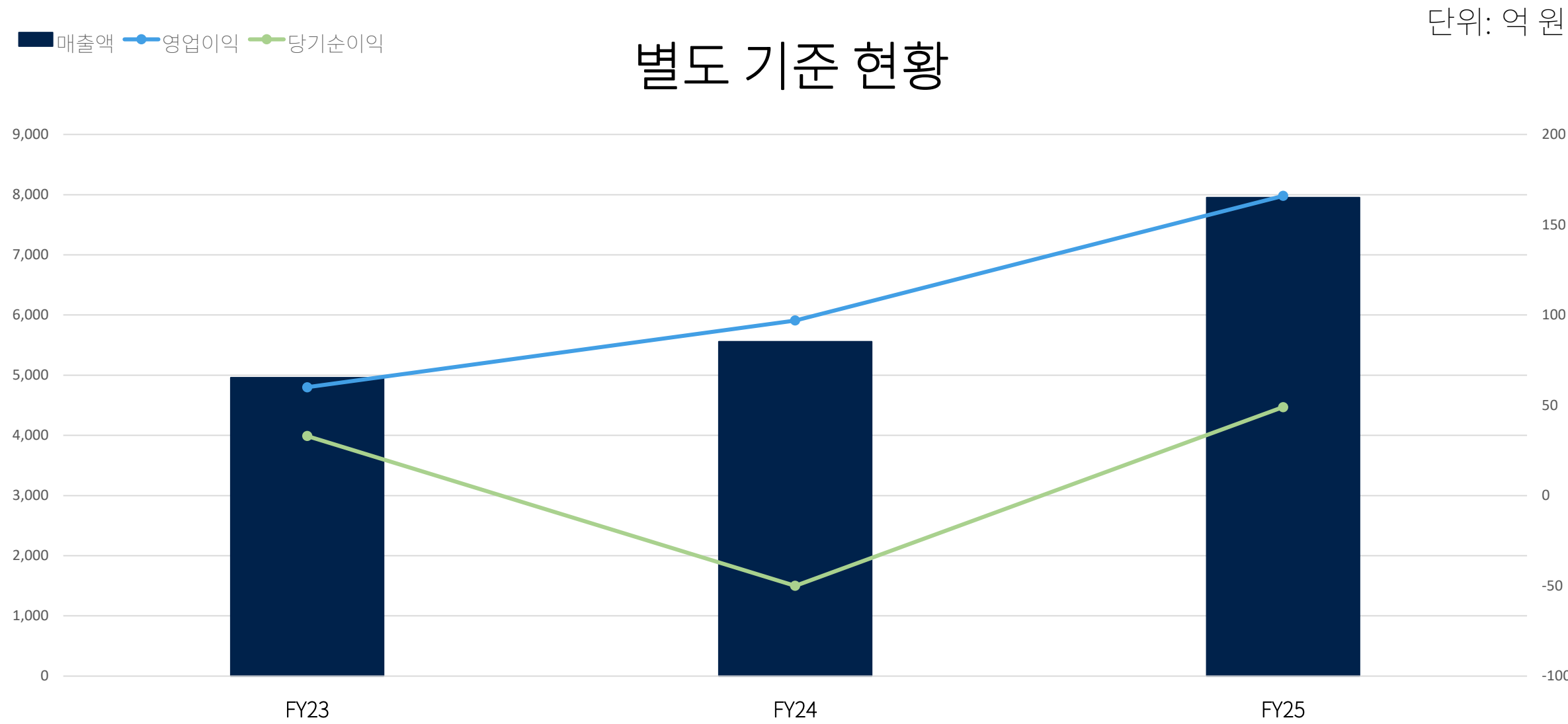
포트폴리오 다변화

- 반도체/비반도체 영역 구분 및 밸류에이션 재평가



Financial Overview

Separate & Consolidated Basis



단위: 억 원

	FY23	FY24	FY25	YoY('24→'25)
매출액	4,960	5,559	7,954	43.07%
영업이익	60	97	166	71.33%
순이익	33	-49	49	흑자전환
자산총계	3,597	3,968	4,739	19.42%
부채총계	2,167	2,652	3,304	24.58%
자본총계	1,430	1,316	1,435	9.03%

단위: 억 원

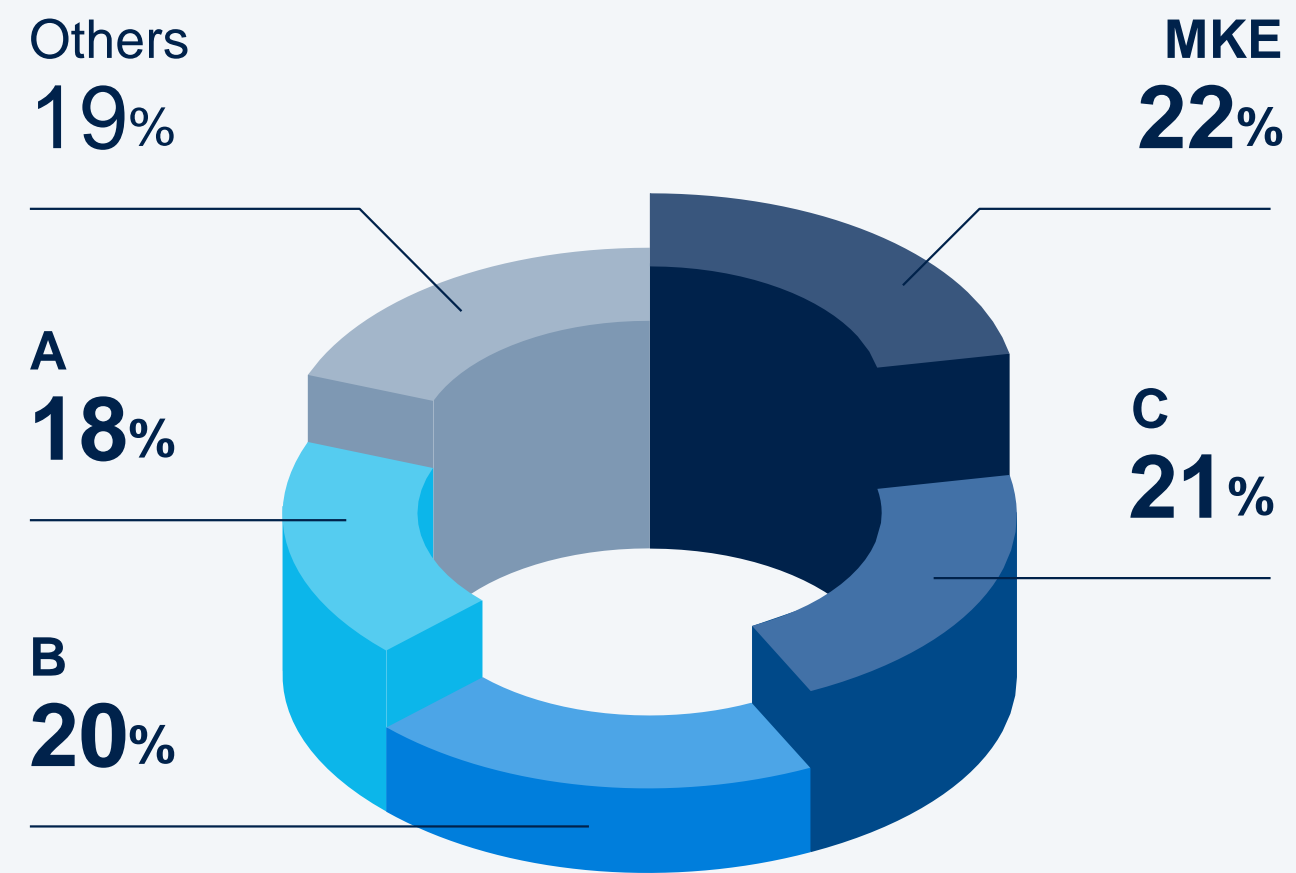
	FY23	FY24	FY25	YoY('24→'25)
매출액	11,169	11,706	14,038	19.92%
영업이익	464	560	141	-74.70%
순이익	-392	-377	207	흑자전환
자산총계	23,078	23,141	25,418	9.84%
부채총계	13,307	14,001	15,348	9.62%
자본총계	9,771	9,140	10,070	10.17%

Core Business_Bonding Wire

Global Market Share and MKE's Strong Points



본딩와이어 판매 글로벌 1위 (M/S: 22%)



01

글로벌 고객사

- 삼성전자, SK하이닉스, ASE, Amkor 등

02

견조한 성장

- 최근 3년 매출 지속 성장

03

세계적 수준의 품질

- 금속 미세도금 기술 보유

04

대규모 생산능력

- 한국본사 + 중국법인: 60~65만 km/월 생산 능력 보유

안정적인 M/S 유지 + SOCAMM 등 본딩와이어 시장 수요 지속 증가 예상

MKE's Portfolio_Bonding Wire

Product Line-up & Key Characteristics



Au Wires (Gold)

- . (정의) 고신뢰성 반도체 패키징용 표준 와이어
- . (특징) 검증된 신뢰성, 안정적인 공정 특성



Metal Coated Copper Wire Series

- . (정의) Cu Core 기반 Pd 또는 Au 도금
- . (특징) 우수한 작업성, 고신뢰성 소재



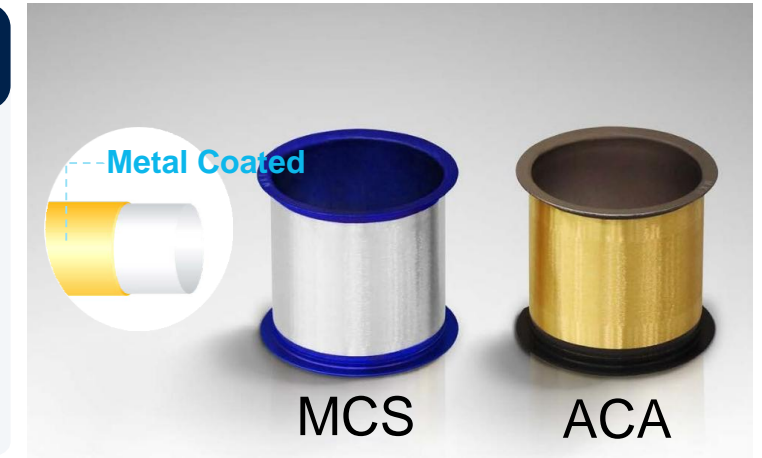
Ag Wires (Silver)

- . (정의) Au Wire 대체용 반도체 패키지
- . (특징) 비용 효율성, 안정성



Metal Coated Silver Wire Series

- . (정의) Ag 합금 기반 Au 또는 X Metal 도금
- . (특징) 우수한 작업성, Gold Wire 대비 비용 효율성



Cu Wires (Copper)

- . (정의) 대량 양산·원가 절감형 반도체 패키지
- . (특징) 고전류 대응 및 전장용 패키지 적용 가능



Al Wires (Aluminum)

- . (정의) 전력·산업용 반도체 패키지
- . (특징) 안정적 본딩과 고객 맞춤 물성 대응



고객사 Award 수상



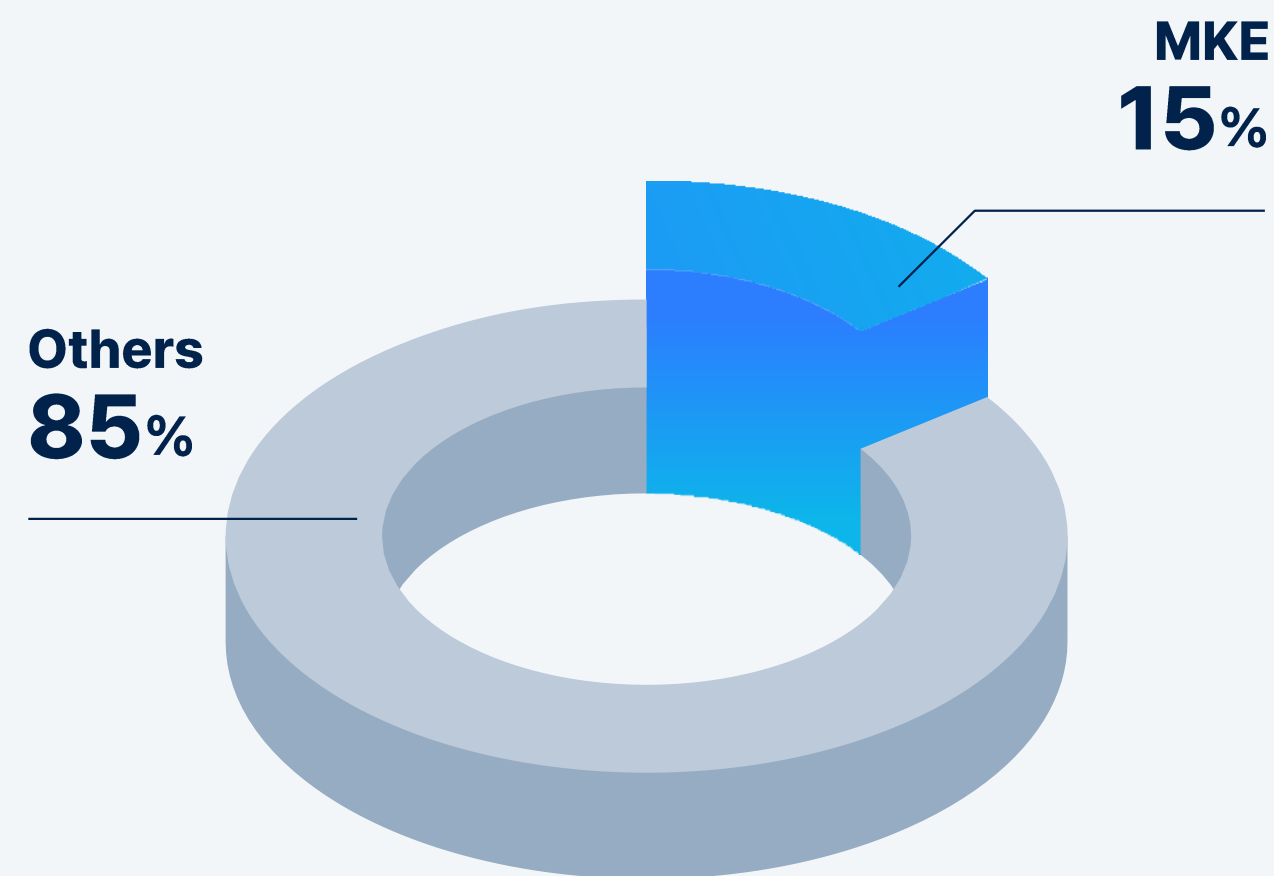
Au Wire 세계일류상품 선정

Core Business_Solder Ball

Global Market Share and MKE's Strong Points



솔더볼 판매 글로벌 3위 (M/S: 15%)



M/S: FY20 10% → FY24 15%
한국 시장 내 2위

01

고객 맞춤형 공급

- General SAC: SAC305, SAC105, SAC1205N..

02

특수 합금

- 고신뢰성(HQM, MXT), 중저온계(LTS), CCSB(Cu Core Solder Ball)

03

Recycle Solder Series

- G-series 탄소 배출 저감 1.6x, Certificated 12개 보유

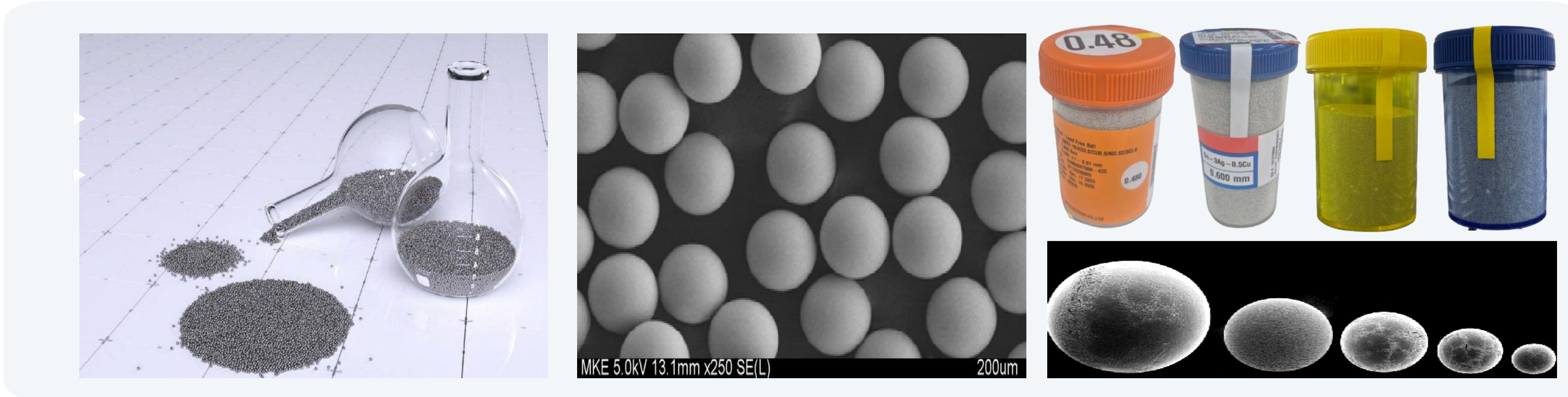
고집적·고성능 패키징 확산에 따라 솔더볼 수요 구조적 증가

MKE's Portfolio_Solder Ball

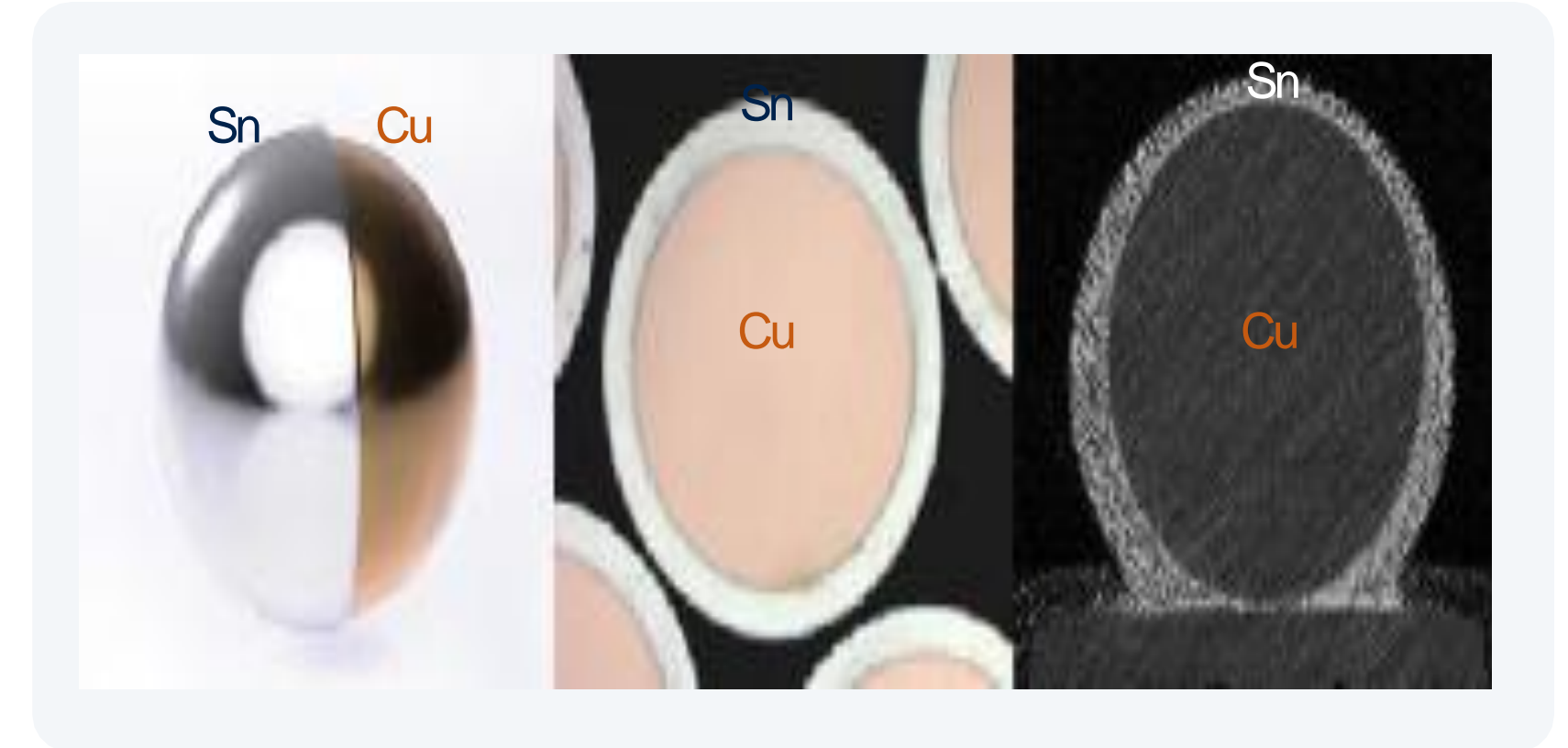
Product Line-up & Key Characteristics



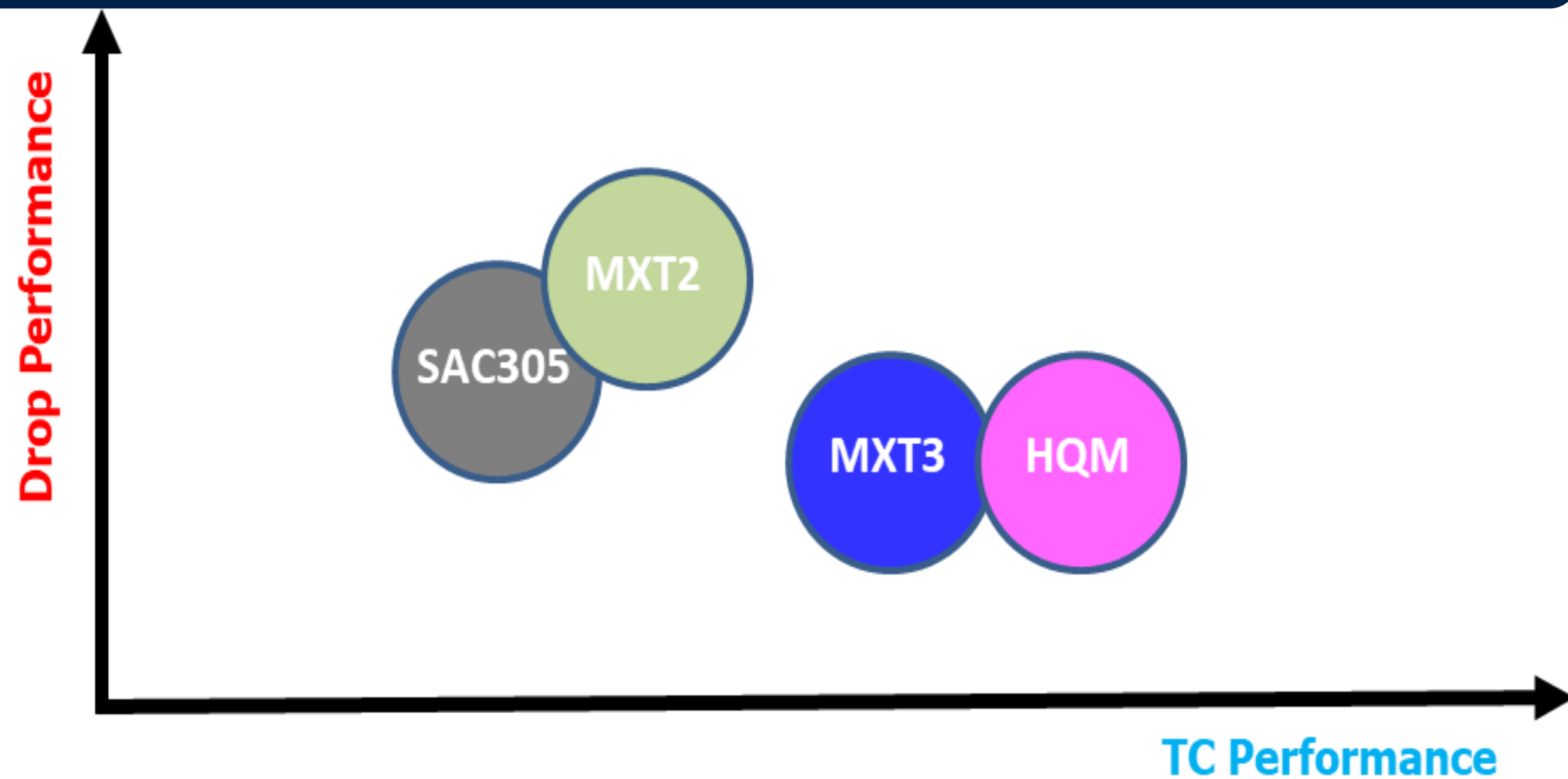
SOLDER BALL



CU CORE SOLDER BALL



HIGH RELIABILITY SOLDER BALL



	SAC	MXT2	MXT3	HQM
Mass production	Yes	Yes	Yes	Yes
TC Rel. on Cu	★	★★	★★★★	★★★★★
Drop Rel. on Cu	★★☆	★★	★	☆
TC Rel. on Ni/Au	★★☆	★★★★	★★★★★	★★★★★
Drop Rel. on Ni/Au	★	★★	☆	☆
Electro-Migration	★★	★★★	★★★★	★★★★☆

New Business_Solder Paste

Background and MKE's Strong Points



01

자체 Flux & Paste 기술 (국내 최초)

- 자체 설계 및 양산 체계 보유
- 고객 요구에 따른 물성 조정 가능

02

통합 생산 체계 (Powder → Flux → Paste)

- 전 공정 내재화
- 원가·속도·품질 경쟁력 확보

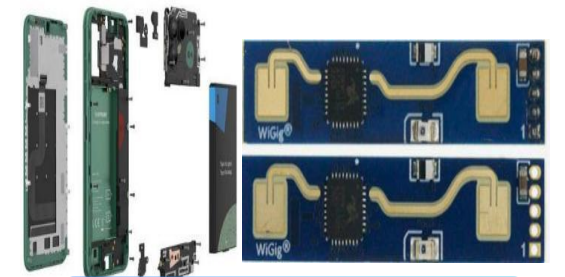
03

미세 피치 패키징 대응 역량

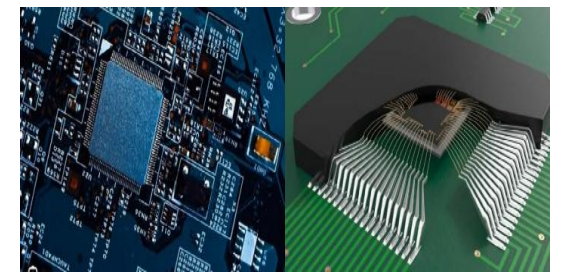
- 고난도 미세 페이스트 개발 기술
- 고집적·고신뢰 패키징 시장 대응



Memory Module



Mobile Module



Semiconductor



Automotive

Solder 제조 역량과 Flux 내재화를 통한 신사업 도입

New Business_Pd Alloy

Background and MKE's Strong Points



01

우수한 가공성 및 높은 수율

- 낮은 와이어 직경 편차, 균일한 물성 및 조성

02

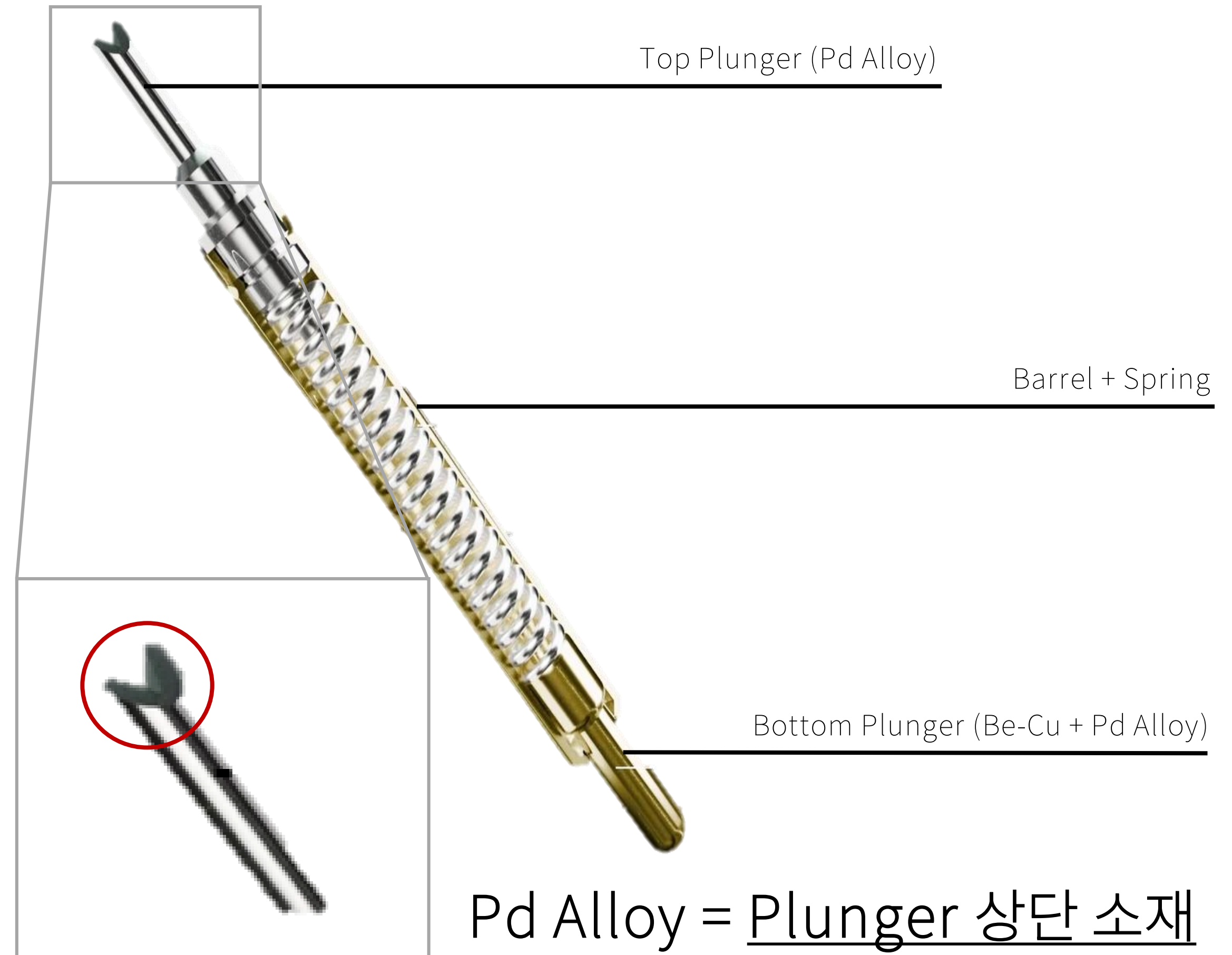
긴 수명과 우수한 내마모성

- 높은 경도·강도, 안정적인 와이어 조직 제어

03

솔더 마이그레이션에 대한 높은 이해도

- 귀금속·솔더 소재 경험



Bonding Wire, Solder Ball 제조 역량을 바탕으로 신사업 도입



CLOSED LOOP RECYCLING SYSTEM



01

국내 유일 재활용 체계 자체 구축

- 인천 리사이클링(전처리) 사업장 → 종합 재활용 사업 허가 보유
- 지정폐기물 및 일반폐기물

02

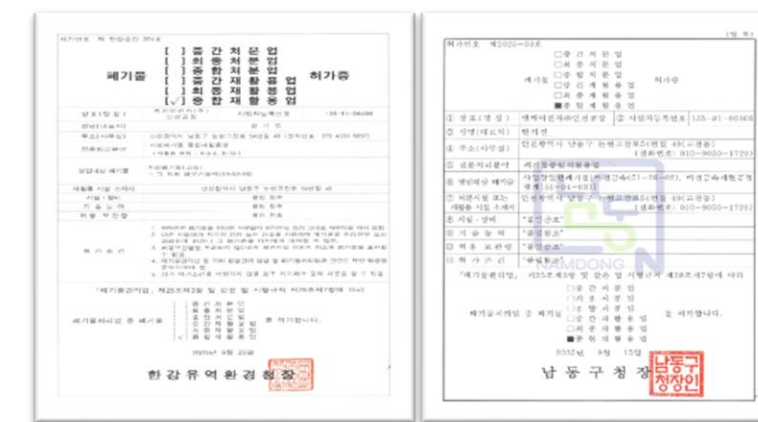
국내 유일 고순도 재활용 금속 생산 체계 구축

- 음성 리사이클링(후처리) 사업장 → 고순도 재활용 금속 생산 (Au, Ag, Sn, Pd 등)
- 귀금속 정련 기반 재활용 기술 보유 → 회수율 99% 달성

03

국내 유일 Solder 자원순환 체계 구축

- ESG Leadership (Net-zero, Recycle 체계, 탄소발자국)
- 친환경 Solder 제품 (기존 금속 대비 탄소배출 약 50% 저감)



폐기물 인허가 ('25년 9월)



음성 사업장 전경



UL 인증

MK ELECTRON CO., LTD.

Thank You

© 2026 MK Electron Co., LTD. All rights reserved. Printed in the Republic of Korea.

The information contained herein is general and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will remain accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.